

PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA2406_POW_V1	焊接	QM03323091401	V1	1/2	20230914

1. 加锡位置

顶层

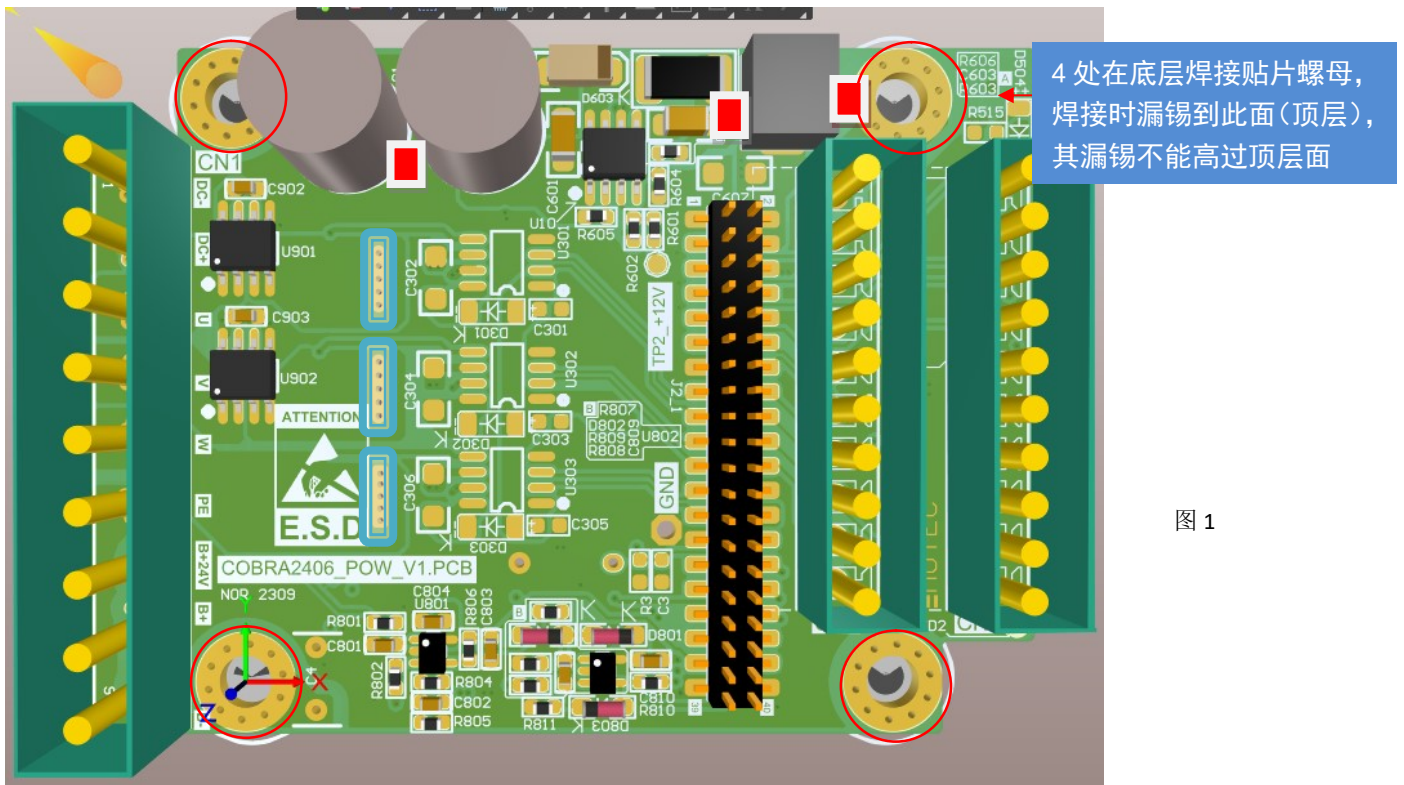



图 1

 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内从顶层至底层注满焊锡；

底层

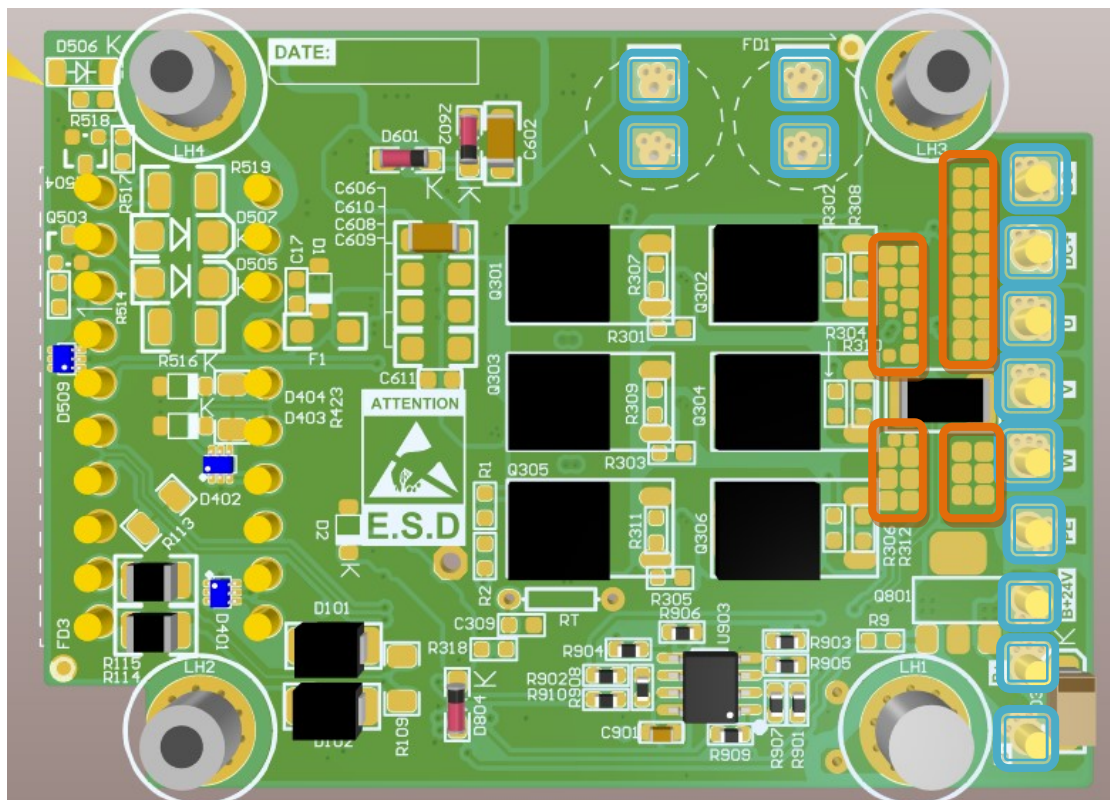




图 2

-  橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm；
-  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡；

PCB 焊接	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
工艺要求	直流伺服	COBRA2406_POW_V1	焊接	QM03323091401	V1	2/2	20230914

2. 焊接基本要求

- 1) 功率管 Q301~Q306 共计 6 个 (TO-252 封装的管子)，紧贴线路板焊接；禁止浮高；
- 2) 温感热敏电阻 RT 紧贴 PCB 的下表面焊接 (见图 3)；
- 3) 注意贴片螺母的型号，LH1~LH4 位置焊接 SMTWE3340MTJ (无螺纹中通支撑柱)

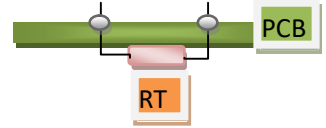
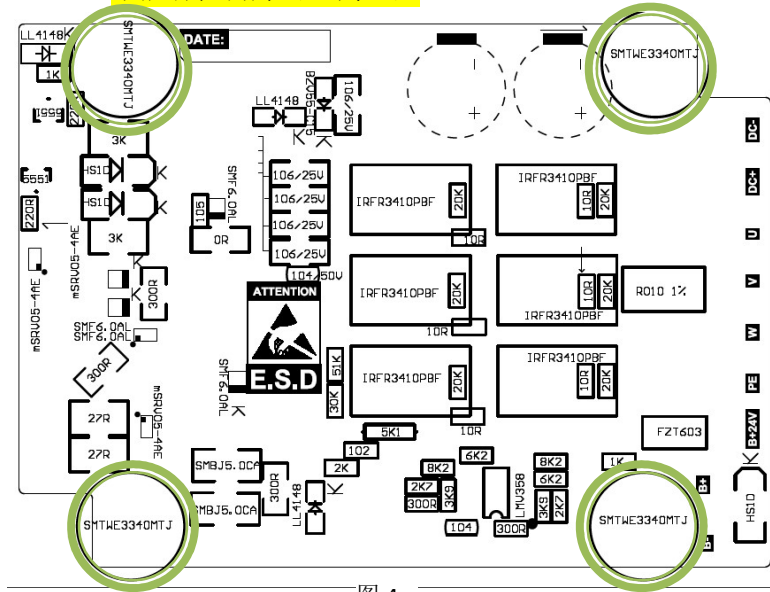


图 3

贴片螺母规格：SMTWE3340MTJ (绿色字符为高度：40 为 4mm 高)

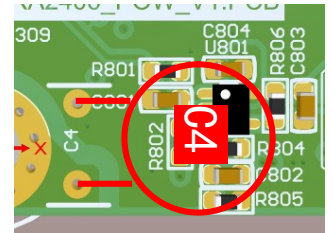


- A) 所有贴片螺母的焊接均须垂直于主板落到底焊接，严禁歪斜；
- B) 所有贴片螺母焊接后，其焊锡不能高出顶层图 1 所示 (红色框内) 的上表面 (该位置为塑壳铜螺母锁定位置，不能有任何焊锡垫高)；



※贴片螺母均贴装在底层

图 4



- 4) 功率板顶层的 C4 (红色标识电容) 要求卧式焊接
- 5) 排针居中，对齐中心位置焊接，XY 方向偏差小于 0.3mm，严禁浮高现象；
- 6) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不容许歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 7) 顶层电解电容 C1 和 C2，电感 L1，按照图 1 的红色区域，涂覆 704 黑色胶，粘接与线路板，胶的厚度为 1.5mm，不要拉丝；
- 8) 所有极性元件严禁方向反；
- 9) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 10) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 11) 手工操作要做防静电处理；
- 12) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 13) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件；

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	